

鑫科材料科技股份有限公司 沿革

89年3月	設立登記。
90年3月	辦理現金增資 3,830 仟股，增資後實收資本額為 88,304 仟元，並由中盈投資開發股份有限公司取得經營權。
95年10月	通過 ISO 9001 認證。
97年2月	通過 ISO 14001 認證。
97年6月	通過 OHSAS 18001 認證。
98年9月	通過 ISO 9001:2008 版認證。
99年5月	鋁合金靶材成功導入觸控面板產業，並通過客戶認證後開始量產。 銀合金靶榮獲國家發明獎金牌。
99年11月	成功通過 IECQ QC 080000 認證。
100年2月	正式興櫃掛牌。同期於薩摩亞設立 Thintech Global Limited。
100年6月	液晶面板用鋁靶榮獲行政院傑出光電產品獎。
101年7月	通過 ISO 17025 TAF 化學測試領域之認證。
101年11月	正式上櫃掛牌。開發藍光光碟用介電靶材並通過客戶認證。
102年9月	導入 AEO 安全優質企業認證。
103年5月	液晶面板用鋁靶榮獲國家發明獎銀牌。
103年11月	通過 IECQ QC 080000:2012 年版認證。
104年2月	開發平模鍛造成形均勻度之改良方法，並取得中華民國專利證書。
104年3月	開發接合式管狀濺鍍靶材及其製作方法，並取得中華民國專利證書。
104年5月	開發「光電產業用低氧純鈦靶材」，於 104 年 6 月獲得第十八屆傑出光電產品獎。
104年7月	開發高蒸氣壓不包含硫之硫屬元素合金塊材之製造方法，並取得中華民國專利證書。
105年7月	通過 ISO 14001:2015 年版國際認證。
106年9月	通過 ISO 9001:2015 年版國際認證。
107年7月	通過 IECQ QC 080000:2017 年版國際認證。
108年7月	開發半導體蒸鍍用金屬材料，開始量產銷售；通過 ISO 45001:2018 年版國際認證。
108年11月	通過 ISO 17025:2017 年版國際認證。
109年3月	半導體封測用靶材通過客戶認證，開始放量銷售。
109年4月	完成半導體中段晶圓減薄 NiV、Ag、Ti 靶材送樣。
109年6月	開發大世代面板週邊設備零組件，開始量產銷售。
109年12月	完成國內半導體中段晶圓減薄 NiV 靶材第一階段上機驗證。
109年12月	導入真空熱模連續鑄製程設備。
109年12月	獲選科技部南部科學園區管理局「推動職場工作平權」優良事業單位。
110年5月	取得第二代半導體晶圓代工廠合格供應商資格。
110年6月	國內第二代化合物半導體用 Au 靶材上機驗證通過並取得供應商資格。
110年7月	光碟產業新型介電靶材認證通過，開始量產。
110年8月	通過國內半導體中段晶圓減薄 NiV、Ag 靶材產品稽核。
110年8月	取得半導體中段晶圓減薄廠合格供應商資格。
110年9月	首編 109 年度企業社會責任報告書。
110年10月	半導體級 Ag slug 於國內某晶圓減薄廠，成功導入在地化供應。
110年12月	第二代半導體用 Au 蒸鍍材認證通過並取得供應商資格。
111年1月	通過 GaAs 第二代半導體客戶 Ni / Ti 蒸鍍材驗證放量。

111年1月	通過 SiC 第三代半導體客戶用鋁合金靶上機驗證通過並取得供應商資格。
111年5月	取得中鋼年度股東會紀念品承製資格。
111年8月	通過國內半導體中段晶圓減薄蒸鍍材、耗材驗證，開始量產。
111年9月	榮獲 111 年度勞動部職業安全衛生署表揚頒獎企業永續報告公開職業健康與安全指標評比-績優企業。
111年12月	開發扇外型封裝領域之載具材料，開始量產銷售。
111年12月	跨入生醫材料領域硼中子捕獲治療設備材料供應。
112年1月	核准發行國內第三次有擔保轉換公司債。
112年5月	取得 IATF 16949：2016 汽車業品質管理系統驗證。
112年6月	股東會通過以現金及普通股新股為對價，收購取得常州中鋼精密鍛材有限公司之 70% 股權案。
112年9月	榮獲 112 年度勞動部職業安全衛生署表揚頒獎企業永續報告公開職業健康與安全指標評比-績優企業。
112年11月	國內第三次有擔保轉換公司債轉換 3,236 股，轉換後實收資本額為 735,012 仟元。
113年5月	完成收購常州中鋼精密鍛材有限公司 70% 股權。
113年5月	獲選科技部南部科學園區管理局「推動職場工作平權」優良事業單位。
113年7月	國內第三次有擔保轉換公司債轉換 27,471,042 股，轉換後實收資本額為 1,009,723 仟元。
113年10月	國內第三次有擔保轉換公司債轉換 3,810,868 股，轉換後實收資本額為 1,047,832 仟元。
113年11月	國內第三次有擔保轉換公司債轉換 2,999,945 股，轉換後實收資本額 1,077,831 仟元。
114年1月	跨入貴金屬回收洗淨領域。
114年3月	國內第三次有擔保轉換公司債轉換 710,926 股，轉換後實收資本額 1,084,941 仟元。
114年5月	跨入實驗室鍍金機貴金屬 Au/Pt 用靶供應
114年6月	跨入半導體 RDL 金屬靶材量產供應。
114年8月	榮獲 TIRI 上櫃中小型股【2025 第一屆 潛力進展獎】
114年10月	榮獲 114 年度勞動部職業安全衛生署表揚頒獎企業永續報告公開職業健康與安全指標評比-績優企業。
114年12月	榮獲 114 年度中華民國科技管理學會【科技管理獎】。
115年3月	跨入前段晶圓廠材料供應及放量。
115年4月	第 12 屆「公司治理評鑑」排名第二級距。